

Express5800/T110j-S(水冷) スペック詳細

2018年12月27日版

フレームモデル

製品名称		Express5800/T110j-S(フレームモデル)	
製品型名		N8100-2671Y	N8100-2672Y
CPU	搭載CPU	インテル® Xeon® プロセッサー E-2124 3.3GHz	インテル® Xeon® プロセッサー E-2136 3.3GHz
	動作周波数	1/1	
	標準搭載数 / 最大搭載数	32KB Instruction / 32KB Data 256KB	
	一次キャッシュ (コアあたり)		
	二次キャッシュ (コアあたり)		
	インテル® スマート・キャッシュ (ラスト・レベル・キャッシュ)	8MB	12MB
	コア数(CPUスレッド数)(T1 CPU)	4C/4T	6C/12T
	コントローラ・ハブとの接続	DMI3 (8GB/s)	
	インテル® 64	対応	
	インテル® バーチャライゼーション・テク/ロジ	対応	
	インテル® ハイパースレッディング・テク/ロジ	-	-
	インテル® ターボ・ブースト・テク/ロジ	対応	対応
	ターボ・ブースト時の最高周波数	3.9GHz	3.3GHz
	インテル® TXT	対応	対応
熱設計電力(TDP)	71W	80W	
CPUソケット形状	LGA1151		
ホットプラグ			
冷却方式	水冷式ヒートシンク		
チップセット	インテル® C246 チップセット		
ダイレクトI/O向けインテル® バーチャライゼーション・テク/ロジ	対応		
メモリ	搭載容量 標準 / 最大	標準搭載なし(セレクトابلオプション)/ 64GB (4x 16GB)	
	メモリスロット数	4	
	増設単位	1	
	搭載メモリ	DDR4-2666 SDRAM DIMM, Unbuffered	
	最大動作周波数	2666MHz	
	メモリーバス帯域(チャネルあたり)	21.3GB/s	
	メモリアクセス方式	インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリア実装方法に応じて2wayインターリーブもサポート)	
	誤り検出・訂正	ECC	
	メモリスベアリング	-	
	メモリースターリング	-	
	ホットプラグ	-	
	モジュールピン数	288ピン	
	動作電圧	1.2V	
	バックアップ機能	なし	
補助記憶装置	ドライブベイ	内蔵標準	-
		内蔵最大	3.5型HDDケーシング(N8154-136選択時) : SATA 24TB (2x 12TB) 2.5型HDDケーシング(N8154-82/83*1選択時) : SATA 12TB (6 x 2TB), SAS 14.4TB (6x 2.4TB), SATA SSD 9.6TB (6x 1.6TB), SAS SSD 2.4TB (6x 400GB) 3.5型/2.5型HDDケーシング(N8154-136/83*1)選択時: SATA 28TB (2x 12TB + 2x 2TB), SATA+SAS 28.8TB (2x 12TB SATA + 2x 2.4TB SAS)
		ホットスワップ	対応(N8154-82またはN8154-82/-83選択時)
	インタフェース規格とRAID構成*2	SATA 6Gb/s : RAID 0/1/10(標準), RAID 5/6/50/60(オプション) SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60(オプション)	
	光ディスクドライブ	標準搭載無し(セレクトابلオプション): 内蔵DVD-ROM, 内蔵DVD SuperMULTI, 光ディスクドライブベイカバーのどれか一つを選択必須*3	
	デバイスベイ	1x 3.5型デバイスベイ *1	
	拡張スロット	1x PCI Express 3.0 (x1&ーン, x16/ケット)	
		3x PCI Express 3.0 (x4&ーン, x8/ケット)	
	規格	PCI Express 3.0	
	搭載チップ / ビデオRAM	マネージメントコントローラチップ内蔵 / 32MB	
グラフィック表示 と 解像度*9	1677万色: 640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1920x1080 5x USB3.0 (2x前面(Type A), 1x 内部(Type A), 2x 背面(Type A)) 2x USB3.1 (2x背面(Type A)) 1x アナログRGB (E-20-Sub19Cン, 1x 背面) 1x シリアルポート (RS-232C規格準拠D-Sub9Cン, シリアルポートA, 1x前面, オプションで計2ポートに増設可) 2x 1000BASE-T LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45, 2x 背面) 1x マネージメント用LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45, 1x 背面)		
標準インターフェース	実装形式	オンボード	
		2x Broadcom® BCM5720	
	コントローラ	対応	
	チーミング	対応 (オプションボードとの組み合わせはシステム構成ガイドを参照願います)	
	FEC / GEC	対応	
	ジャンボフレーム	対応(Linuxの対応状況は、NECコーポレートサイトのLinuxドライバ情報を参照願います)	
	PXE / SCSI ブート	PXE対応/SCSIブート非対応	
	リモート	Aspeed AST2500 integrated BaseBoard Management Controller (iBMC)	
	マネージメント	Realtek RTL8211E-VB-CG	
	WHEA(Windows Hardware Error Architecture)	対応	
	キーボード / マウス	標準添付	
	BIOS	American Megatrends Inc. Aptio ®	
	冗長電源		
	冗長ファン		
筐体デザイン	スリムタワー		
	外形寸法 (幅x奥行きx高さ)*4 98.0mm x 386.5mm x 341.0mm x 34		

8GBメモリ搭載モデル

製品名称		メモリ搭載モデル
製品型名		NP8100-2671YP2Y
CPU	搭載CPU	インテル® Xeon® プロセッサー E-2124 3.3GHz
	動作周波数	1/1
	標準搭載数 / 最大搭載数	32KB Instruction / 32KB Data
	一次キャッシュ (コアあたり)	256KB
	二次キャッシュ (コアあたり)	8MB
	インテル® スマート・キャッシュ (ラスト・レベル・キャッシュ)	
	コア数(C)/スレッド数(T) (1CPU)	4C/4T
	コントローラ・ハブとの接続	DMI3 (8GB/s)
	インテル® 64	対応
	インテル® バイチャライゼーション・テク/ロジ	対応
	インテル® ハイパースレッディング・テク/ロジ	-
	インテル® ターボ・ブースト・テク/ロジ	対応
	ターボ・ブースト時の最高周波数	3.9GHz
	インテル® TXT	対応
	熱設計電力(TDP)	71W
チップセット	CPUソケット形状	LGA1151
	ホットプラグ	
	冷却方式	水冷式ヒートシンク
	ダイレクトI/O向けインテル® バイチャライゼーション・テク/ロジ	インテル® C246 チップセット
		対応
		Unbuffered DIMM : 8GB (1x 8GB)/ 64GB (4x 16GB)
	搭載容量 標準 / 最大	
	メモリソケット数	4
	増設単位	1
	搭載メモリ	DDR4-2666 SDRAM DIMM, Unbuffered
	最大動作周波数	2666MHz
	メモリバス帯域(チャネルあたり)	21.3GB/s
	メモリアクセス方式	インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法に応じて2wayインターリーブもサポート)
	誤り検出・訂正	ECC
メモリ	メモリスベアリング	-
	メモリエラー・リング	-
	ホットプラグ	-
	モジュールピン数	288ピン
	動作電圧	1.2V
	バッファ機能	なし
		-
		3.5型HDDケージ(N8154-136選択時) : SATA 24TB (2x 12TB)
		2.5型HDDケージ(N8154-82/-83*1選択時) : SATA 12TB (6 x 2TB), SAS 14.4TB (6x 2.4TB), SATA SSD 9.6TB (6x 1.6TB), SAS SSD 2.4TB (6x 400GB)
		3.5型/2.5型HDDケージ(N8154-136/-83*)1選択時: SATA 28TB (2x 12TB + 2x 2TB), SATA+SAS 28.8TB (2x 12TB SATA + 2x 2.4TB SAS)
		対応(N8154-82またはN8154-82/-83選択時)
		SATA 6Gb/s : RAID 0/1/10(標準), RAID 5/6/50/60(オプション)
		SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60(オプション)
		標準搭載無し(セレクトタブオプション): 内蔵DVD-ROM、内蔵DVD SuperMULTI、光ディスクドライブベイクバーのどれか一つを選択必須*3
補助記憶装置	ドライブ	
	内蔵標準	
	内蔵最大	
	ホットスワップ	
	インタフェース規格とRAID構成*2	
	光ディスクドライブ	
	デバイスベ	
拡張スロット	対応スロット	
	規格	
	搭載チップ / ビデオRAM	
グラフィックス	グラフィック表示 と 解像度*9	
標準インタフェース		
標準ネットワーク	実装形式	
	コントローラ	
	チーミング	
リモートマネージメント	FEC / GEC	
	ジャンボフレーム	
	PXE / iSCSI ブート	
WHEA(Windows Hardware Error Architecture)	コントローラ	
	マネージメント	
	マネージメント用ポート	
キーボード / マウス		
BIOS		
冗長電源		
冗長ファン		
筐体デザイン		
外形寸法 (幅x奥行きx高さ)*4		
質量 (標準 / 最大)		
電源		
消費電力(100V最小構成時, 25℃待機時)		
消費電力(100V最小構成時, 25℃高負荷時)		
消費電力(100V最大構成時, 25℃待機時)		
消費電力(100V最大構成時, 25℃高負荷時)		
消費電力(100V最大構成時, 最大電力)		
消費電力(200V最大構成時, 25℃待機時)		
消費電力(200V最大構成時, 25℃高負荷時)		
消費電力(200V最大構成時, 最大電力)		
消費電力(100V最大構成時, 装置ラベル記載値)		
省エネ法(2011年度基準)に基づくエネルギー消費効率		
音量*6		
測定方式		
温度/湿度条件		
ハードウェア認証規定		
OS認証		
主な添付品		
無償保証内容		
インストールOS		
サポートOS	NECサポート	
動作確認OS*8		

ExpressSelectionPack

製品名称		ExpressSelectionPack	
製品型名		NP8100-2671YP1Y	
CPU	搭載CPU	インテル® Xeon®	
		プロセッサ	
	動作周波数	E-2124	
		3.3GHz	
	標準搭載数 / 最大搭載数	1/1	
	一次キャッシュ (コアあたり)	32KB Instruction / 32KB Data	
	二次キャッシュ (コアあたり)	256KB	
	インテル® スマート・キャッシュ (ラスト・レベル・キャッシュ)	8MB	
	コア数(C)/スレッド数(T) (1CPU)	4C/4T	
	コントローラ・ハブとの接続	DMI3 (8GB/s)	
	インテル® 64	対応	
	インテル® パーチャライゼーション・テクノロジ	対応	
	インテル® ハイパースレッディング・テクノロジ	-	
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジ	対応		
ターボ・ブースト時の最高周波数	3.9GHz		
インテル® TXT	対応		
熱設計電力(TDP)	71W		
CPUソケット形状	LGA1151		
ホットプラグ			
冷却方式	水冷式ヒートシンク		
チップセット		インテル® C246 チップセット	
ダイレクトI/O向けインテル® パーチャライゼーション・テクノロジ		対応	
メモリ	搭載容量 標準 / 最大	標準搭載なし(セレクトラブルオプション) / 64GB (4x 16GB)	
	メモリソケット数	4	
	増設単位	1	
	搭載メモリ	DDR4-2666 SDRAM DIMM, Unbuffered	
	最大動作周波数	2666MHz	
	メモリアス帯域(チャネルあたり)	21.3GB/s	
	メモリアクセス方式	インディペンデントチャネルアクセス方式 (メモリ実装方法に応じて2wayインターリーブもサポート)	
	誤り検出・訂正	ECC	
	メモリスベアリング	-	
	メモリスターリング	-	
	ホットプラグ	-	
	モジュールピン数	288ピン	
	動作電圧	1.2V	
バッファ機能	なし		
補助記憶装置	内蔵標準	-	
	ドライブベイ	内蔵最大	
	ホットスワップ	3.5型HDDケージ(N8154-136選択時) : SATA 24TB (2x 12TB) 2.5型HDDケージ(N8154-82/-83*1選択時) : SATA 12TB (6 x 2TB), SAS 14.4TB (6x 2.4TB), SATA SSD 9.6TB (6x 1.6TB), SAS SSD 2.4TB (6x 400GB) 3.5型/2.5型HDDケージ(N8154-136/-83*1)選択時: SATA 28TB (2x 12TB + 2x 2TB), SATA+SAS 28.8TB (2x 12TB SATA + 2x 2.4TB SAS)	
	インタフェース規格とRAID構成*2	対応(N8154-82またはN8154-82/-83選択時) SATA 6Gb/s : RAID 0/1/10(標準), RAID 5/6/50/60(オプション) SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60(オプション)	
	光ディスクドライブ	標準搭載無し(セレクトラブルオプション) : 内蔵DVD-ROM、内蔵DVD SuperMULTI、光ディスクドライブベिकाバーのどれか一つを選択必須*3	
	デバイスベイ	1x 3.5型デバイスベイ*1	
	拡張スロット	1x PCI Express 3.0 (x16レーン, x16ソケット) 3x PCI Express 3.0 (x4レーン, x8ソケット)	
	規格	PCI Express 3.0	
	搭載チップ / ビデオRAM	マネージメントコントローラチップ内蔵 / 32MB	
	グラフィック表示と解像度*9	1677万色: 640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1920x1080 5x USB3.0 (2x 前面(Type A)、1x 内部(Type A)、2x 背面(Type A)) 2x USB3.1 (2x 背面(Type A)) 1x アナログRGB (ミニD-Sub15ピン, 1x 背面) 1x シリアルポート (RS-232C規格準拠/D-Sub9ピン/シリアルポートA、1x背面、オプションで計2ポートに増設可) 2x 1000BASE-T LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45, 2x 背面) 1x マネージメント用LANコネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応, RJ-45, 1x 背面)	
標準インタフェース	オンボード		
	2x Broadcom® BCM5720		
標準ネットワーク	チーミング	対応 (オプションボードとの組み合わせはシステム構成ガイドを参照願います)	
	FEC / GEC	対応	
	ジャンボフレーム	対応(Linuxの対応状況は、NECコーポレートサイトのLinuxドライバ情報をご参照ください)	
	PXE / iSCSI ブート	PXE対応/iSCSIブート非対応	
リモートマネージメント	コントローラ	Emulex Pilot 3 integrated BaseBoard Management Controller (iBMC)	
	マネージメント用ポート	Realtek RTL8211E-VB-CG	
WHEA(Windows Hardware Error Architecture)	対応		
キーボード / マウス	標準添付		
BIOS	American Megatrends Inc. Aptio ®		
冗長電源	-		
冗長ファン	-		
筐体デザイン	スリムタワー		
外形寸法 (幅x奥行きx高さ)*4	98.0mm x 386.5mm x 341.0mm ｾﾀﾞﾞﾗｲｻﾞ・突起物含まず) 200.0mm x 423.7mm x 347.1mm (ｽﾀﾃﾞｲﾗｲｻﾞ・突起物含む)		
質量 (標準 / 最大)	8.0kg / 11.5kg		
電源	1x 250W 80 PLUS® Platinum 取得電源(二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ不可) AC100V/200V±10%、50/60Hz±3Hz(AC100V用電源ケーブル1本を添付)		
消費電力(100V最小構成時、25℃待機時)	20VA/20W		
消費電力(100V最小構成時、25℃高負荷時)	80VA/79W		
消費電力(100V最大構成時、25℃待機時)	100VA/99W		
消費電力(100V最大構成時、25℃高負荷時)	183VA/182W		
消費電力(100V最大構成時、最大電力)	212VA/211W		
消費電力(200V最大構成時、25℃待機時)	99VA/98W		
消費電力(200V最大構成時、25℃高負荷時)	181VA/180W		
消費電力(200V最大構成時、最大電力)	210VA/209W		
消費電力(100V最大構成時、装置ラベル記載値)			
発熱量	759.60KJ/h		
省エネ法(2011年度基準)に基づくエネルギー消費効率	*5		
音量*6	音圧レベル(100V最小構成時、待機時) 25℃	28.2 dBA	
	音圧レベル(100V最小構成時、高負荷時)25℃	33.4 dBA	
	音圧レベル(100V最大構成時、待機時)25℃	37.0 dBA	
	音圧レベル(100V最大構成時、高負荷時)25℃	41.0 dBA	
	音圧レベル(100V最大構成時、待機時)35℃	44.0 dBA	
	音圧レベル(100V最大構成時、高負荷時)35℃	50.0 dBA	
	音圧レベル(100V最大構成時、待機時)48℃	67.5 dBA	
	音圧レベル(100V最大構成時、高負荷時)48℃	67.5 dBA	
測定方式	ISO7779基準、オペレータ位置測定 (床: 1.2m、サーバとの距離: 0.5m)、サーバ設置 (床: 0.75m)、環境温度25℃		
温度/湿度条件	動作時 : 5～40℃ (オプション適用時: 5℃～48℃、構成制限あり) / 10～85% (ただし結露しないこと) 保管時 : -10～55℃ / 10～85% (ただし結露しないこと)		
ハードウェア認証規定	VCCI クラス A		
OS認証	Windows Logo Program, Red Hat Certified Hardware, VMware Certification Program		
主な添付品	スタートアップガイド、保証書、AC100V用電源ケーブル (ケーブル長:3.0m)、キーボード (ケーブル長: 1.8m)、マウス (ケーブル長: 1.8m)		
無償保証内容	3年オンサイト保守サービス(月～金、9:00～18:00、営業日対応、国民の祝日および年末年始等のNEC指定日を除く)		
インストールOS	Microsoft® Windows Server® 2016 Standard		
サポートOS	NECサポート	Microsoft® Windows Server® 2016 Standard、Microsoft® Windows Server® 2016 DatacenterMicrosoft®	
		VMware ESXi™ 6.5 Update2 *10、VMware ESXi™ 6.7 Update1 *7	
		Red Hat® Enterprise Linux® 7.5以降 *7	
		最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux on Express5800」を参照願います	
動作確認OS *8			

注意事項

インテル パーチャライゼーション・テクノロジ 対応していないCPUはWindows Server 2008R2/2012/2012 R2にて提供されるHyper-Vには未対応となります (Windowsをサポートしている製品の場合)

拡張スロット 搭載可能なボードの奥行きはFull Height PCI: ロングサイズ = 312mmまで、ショートサイズ = 173.1mmまで、Low Profile PCI: MD1 = 119.9mmまで、MD2 = 167.6mmまでを示します

騒音値/電力 騒音値、電力に記載されている待機時とはOS起動時ログイン前の状態を示す

装置ラベル記載値が許容できる電力値の上限です。実運用上の消費電力については、最大電力値をご参照ください。

注釈

*1 2.5型増設用HDDケージと3.5型バックアップデバイスは排他実装

*2 各RAID構成への内蔵ドライブ(HDD/SSD)対応状況については、システム構成ガイド内の内蔵ドライブの項を参照下さい。

*3 内蔵DVD-ROMまたは内蔵DVDSuperMULTIをシステムに搭載しない場合、保守時およびOS再インストール時に備えて外付DVDドライブをシステムで最低1式は必ず手配して下さい。

*4 防塵ベゼル実装時の外形寸法については、構成ガイドの「防塵ベゼル / 防塵フィルタ」の項を参照願います。

*5 省エネ法(2011年度基準)の規制対象外です。

*6 測定条件はISO7779準拠、環境温度25℃、高負荷時の値、数値は環境温度、製品個体差により上下します。音量は上記条件の測定結果であり、全ての環境において値を保証するものではありません。また、光ディスクドライブやバックアップ装置等の動作音については本測定の対象外です。

*7 インストールには5GB以上の論理メモリ容量が必要です。

*8 BTOインストール不可、NECは動作確認情報のみ提供いたします。最新の動作確認情報は、情報発信サイト「Linux on Express5800」を参照願います。

*9 搭載するOSや接続するディスプレイにより対応可否が異なりますので、詳しくはシステム構成ガイド内のディスプレイの項を参照ください。

補足事項

サポートOS毎に依存するスペック制限および接続制限などについては次項以降のシステム構成図およびOS対応表を参照願います。